

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

### 1、会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》

为提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，满足日益增长的市场需求，公司拟通过控股子公司成都集佳科技有限公司投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为 75,845 万元，资金来源为企业自筹。该项目建设期 2 年，达产期 2 年。

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，本次项目投资金额未达到公司最近一期经审计后总资产的 30%，在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 2、会议审议通过了《关于向关联方采购设备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-034。

关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日